

产品技术说明书

BH-PI-D2聚酰亚胺树脂材料

产品牌号：BH-PI-D2

TDS 编号：

修订日期：

版 本：

产品描述

BH-PI-D2聚酰亚胺树脂材料聚酰亚胺材料是主链上含有亚胺环和芳香环，具有链形结构的聚合物，可以在熔融加工过程中再次成型，不会发生化学交联。韧性较BH-PI-D1树脂好，且具有结晶性，使用温度高。

产品特点

- 具有突出的高温使用性能
- 十分优秀的力学性能，有更好的冲击韧性
- 更好的加工性能

用途

- 精密机械、工业机械零件；
- 电工电子零件；
- 汽车及运输设备零件；
- 复印机机械零件
- 印刷线路板、计算机元件；
- 移动电话内部天线及半导体芯片托架。

物理性能*

性能	数值	单位	测试方法
----	----	----	------

颜色	棕黄色	/	/
密度	1.42	g/cm ³	GB/T 1033.1-2008
拉伸强度	≥50	MPa	GB/T 1040.1-2008
断裂伸长率	≥6.0	%	GB/T 1040.1-2008
弯曲强度	≥100	MPa	GB/T 9341-2008
弯曲模量	≥2500	MPa	GB/T 9341-2008
无缺口冲击强度	≥50	kJ/m ²	GB/T 1043.1-2008
压缩强度		MPa	GBT1041-2008
洛氏硬度	≥90	HRE	GB/T 3398.2-2008
吸水性	0.3	%	GB/T 1462-2005
热膨胀系数(CTE)	54(23~350℃)	ppm/K	GBT36800.2-2018
玻璃化温度(Tg)	406	℃	ASTMD4065- 12

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主

免责声明:上海贝泓新材料科技有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表 (MSDS) 的详细资料, 对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前, 联系我们推荐配方中其他原料的供应商, 确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性, 应用, 质量, 安全性, 产品规格, 适销性, 以及针对特定用途的适用性, 本技术数据表中所涉及的内容仅供参考, 无论是明示或隐含的信息, 我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可, 也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。